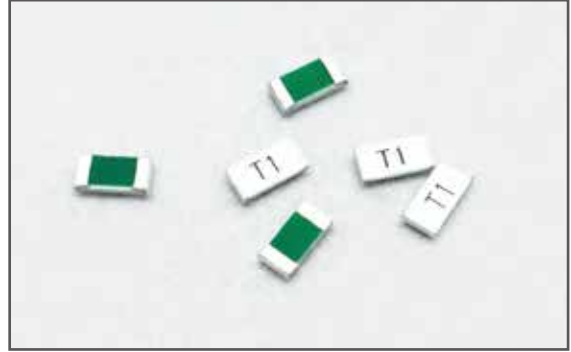


I-T Characteristics / 時間-電流特性

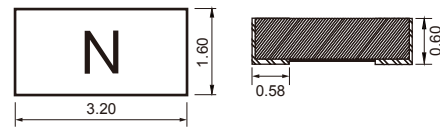
Ampere Rating 額定電流	% of Ampere Rating 額定電流百分比	Opening Time 熔斷時間
500mA~10A	100%	4 Hrs Min. / 最短4小時
	200%	1s Min. 120s Max. / 最短1秒, 最長120秒
	300%	100ms Min. 3s Max. / 最短100毫秒, 最長3秒
	800%	2ms Min. 50ms Max. / 最短2毫秒, 最長50毫秒
	1000%	0.2ms Min. 20ms Max. / 最短0.2毫秒, 最長20毫秒



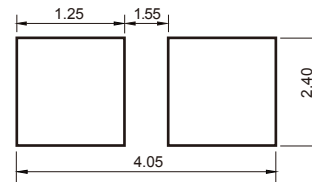
Product Features / 產品特性

Materials 材質	Body / 本體: Cu / 銅, Sn / 錫 Substrate / 基板: alumina ceramic / 氧化鋁陶瓷基板 Electrode / 電極: Cu / 銅, Ni / 鎳, Sn / 錫 (termination with nickel and Pure-tin solder plating / 電極端面為鍍鎳及無鉛錫)
Operating Temperature 操作溫度	-55°C to +150°C (consider de-rating / 需考慮溫度折減)
Solderability 可焊性	T / 熔錫溫度=235°C±5°C, t / 浸錫時間=2+0/-0.5s, Cover / 覆蓋率 ≥95%, ΔS=2.0mm±0.5mm, magnifier: 20X
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱	T / 熔錫溫度=260°C±5°C, t / 浸錫時間=10s ±1s ΔS=2.0mm±0.5mm
Recommended Soldering Parameters 建議焊錫參數	260°C, 10s Max. (compatible with both wave and solder-reflow / 可用于波峰焊和回流焊制程)
Storage Conditions 儲存條件	Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature of +10°C~40°C, relative humidity ≤ 75%. 在溫度+10°C~40°C, 相對濕度 ≤ 75% 的密封條件下可存放 2 年。 At most can be kept 30 days at temperature +10°C~40°C, relative humidity ≤ 95% under covered conditions. 在溫度+10°C~40°C, 相對濕度為 95% 的非露天最多可存放 30 天。

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)



Recommended Pad Layout



Electrical Characteristics / 電氣特性

Rated Current 額定電流	Rated Voltage 額定電壓	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證
1.00A	63V DC	1A~10A 50A@63V DC	●
1.25A	63V DC		●
1.50A	63V DC		●
2.00A	63V DC		●
2.50A	63V DC		●
3.00A	63V DC		●
3.50A	63V DC		●
4.00A	63V DC		●
5.00A	63V DC		●
6.00A	63V DC		●
7.00A	63V DC		●
8.00A	63V DC		●
10.0A	63V DC		●